

深圳市联得自动化装备股份有限公司 投资者关系活动记录表

证券简称：联得装备

证券代码：300545

编号：2024-008

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他 _____
参与单位名称及人员姓名	天风证券、国泰君安资管、旌安投资、国泰君安证券等 4 位机构投资人
时间	2024 年 6 月 27 日
地点	东莞联鹏智能装备有限公司厂区及会议室
上市公司接待人员姓名	董事、董事会秘书：刘雨晴女士
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、介绍公司概况</p> <p>简要介绍公司及子公司发展历程、主营业务、近年主要经营业绩，公司及子公司的核心优势及未来发展规划等情况。</p> <p>二、投资者会议问答交流</p> <p>Q1：公司主要竞争优势有哪些？</p> <p>A1：公司深耕半导体显示设备行业二十余年，经历了显示产业的多种技术变革，通过多年的技术沉淀和积累实现了半导体显示产业各种技术之间的掌握和融合，具备了良好的产品研发设计能力和制造工艺水平，使公司的产品研发设计能力、产品质量性能均处于行业前列。公司凭借优异的产品质量和多年来积累的核心技术优势，以及全方位的、高质量的售前、售中、售后个性化、定制化服务，公司在业内树立了良好的口碑，公司已经拥有一批具有长期稳定合作关系的客户，与包括大陆汽车电子、博世、京东方、维信诺、深天马、德赛西威、华星光电、苹果、华为、富士康、夏普、业成、蓝思科技、惠科等知名企业建立了良好的紧密的合作关系。</p>

公司凭借行业经验优势、研发创新优势、品牌优势、综合服务优势、客户资源优势，实现了公司经营规模及业绩的稳定增长。

Q2: 公司的研发模式是怎样的？

A2: 公司主要采取自主研发模式，拥有经验丰富、创新能力强、稳定的专业研发队伍，形成了完善的研发创新体系和稳固的知识产权保护体系。公司坚持以技术创新和产品创新为核心驱动力，以客户需求为导向，主要采用客户需求定制化研发和行业前瞻性研发相结合的方式。

Q3: 公司在 Mini/Micro LED 显示领域有哪些设备？

A3: 公司目前在 Mini/Micro LED 显示领域，已经推出芯片分选设备、芯片扩晶设备、检测设备、真空贴膜设备、芯片巨量转移设备、高精度拼接设备等。

Q4: 公司在半导体领域主要有哪些设备，发展情况如何？

A4: 公司在半导体领域主要生产半导体后段工序的封装测试设备。主要产品是 COF 倒装机、半导体倒装机、软焊料固晶机、共晶固晶机、AOI 检测机、引线框架贴膜机等高速高精的半导体装备。目前共晶、软焊料等固晶机和 QFN 引线框架贴膜、引线框架检测等设备已经交付客户量产。公司将密切关注行业发展动态和前沿技术的发展趋势，积极创造并把握半导体设备领域的发展机遇。

Q5: 公司的海外市场拓展情况如何？

A5: 在汽车电子领域，公司积累了如大陆汽车电子、博世、伟世通等诸多世界 500 强的客户资源，并建立了良好的合作关系。汽车智能化的发展促使汽车智能座舱系统在整车中扮演越来越重要的角色，带来汽车智能座舱系统相关设备的需求不断壮大，公司在该行业的布局逐渐在订单中变现，特别是公司与国外大客户的深度合作，实现了设备在欧洲、东南亚、北美的落地。

Q6: 公司未来的研发方向是什么？

A6: 公司将持续加强在半导体显示模组设备、汽车智能座舱系统装备、半导体封测设备及新能源装备领域的研发。积极开拓柔性显示模组设备及显示前端工序贴合类设备、Mini/Micro LED 设备、VR/AR/MR 精密组装设

	备、汽车智能座舱系统装备、半导体封测设备以及新能源装备在新兴领域的应用市场，同时继续加大这些领域的新技术、新产品研发力度，支撑该业务快速成长。公司将通过多维度的产品布局，丰富产品种类，完善产品体系，通过内延发展孵化研发团队模式，形成稳健持续的发展平台。
附件清单（如有）	无
日期	2024-6-27